

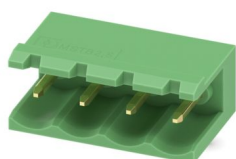
MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTB 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,23 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

- Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
- Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
- El principio de montaje conocido permite el uso universal
- Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
- Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio

Datos comerciales

Código de artículo	1752276
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AACSHB
Clave de producto	AACSHB
GTIN	4017918213985
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,609 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,349 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MSTB 2,5/-G
Línea de productos	COMBICON Connectors M
Número de polos	4
Paso	5,08 mm
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Número de potenciales	4
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	12 A
Tensión nominal U_N	320 V
Resistencia de contacto	2,6 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	parcialmente dorados
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Oro (0,8 - 1,4 μm Au)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (2 - 3 μm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (3 - 5 μm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (1 - 3 μm Ni)

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Notas

Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.
---	--

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	5,08 mm
Anchura [w]	20,32 mm
Altura [h]	11,8 mm
Longitud [l]	12 mm
Altura total	8,57 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,23 mm
Dimensiones de patilla	1 x 1 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,4 mm
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Examen visual

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Examen dimensional

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Resistencia de las rotulaciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Prueba aprobada

Polarización y codificación

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada

Portacontactos usado

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada

Fuerzas al enchufar y desenchufar

Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	100
Fuerza al enchufar por polo aprox.	4 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	4 N

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	18

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	3,2 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 500 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 500 Hz)
Duración de ensayo por eje	2 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	4,8 kV
Resistencia de contacto R_1	2,6 mΩ
Resistencia de contacto R_2	2,6 mΩ
Ciclos de enchufe	100
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	1,0 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	2,21 kV

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

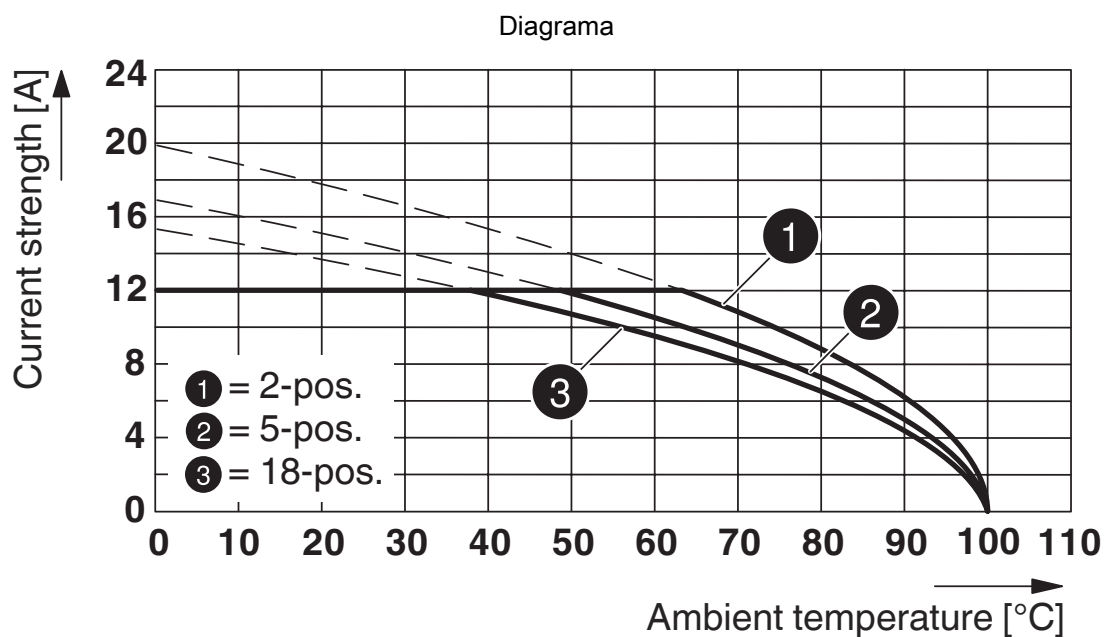
MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



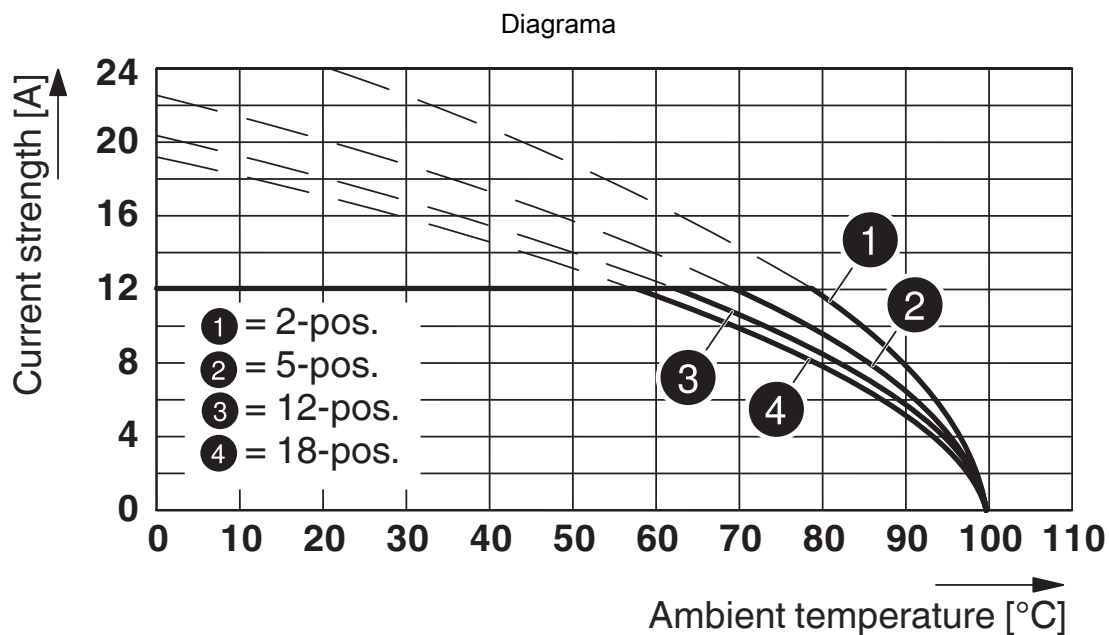
1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Dibujos



Tipo: MVSTBW 2,5/...-ST-5,08 AU con MSTB 2,5/...-G-5,08 AU



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 AU con MSTB 2,5/...-G-5,08 AU

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

CSA ID de homologación: 13631-2585951				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

cULus Recognized ID de homologación: E60425-19931011				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	15 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40050648				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	12 A	-	-

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	Leiterplattengrundleiste
ECLASS-15.0	Leiterplattengrundleiste

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1752276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752276>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es